

## BAT54

### 肖特基二极管芯片(4 " )

■用途:

高速开关应用

电路保护

电压箝位

■特征:

\* 正向压降小

\* 结电容小

\* 适用于片式封装

\* 有效图形数 57500 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	350 μ m×350 μ m
压焊区尺寸	150 μ m×150 μ m
芯片厚度	180±20 μ m
锯片槽宽度	50 μ m
金属层	正面:Al 2.3±0.2μm 背面:Au 1.4±0.2μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	典型值	单位
正向压降	V <sub>F</sub> (1)	I <sub>F</sub> =0.1mA		0.23	0.18	V
	V <sub>F</sub> (2)	I <sub>F</sub> =1mA		0.30	0.25	V
	V <sub>F</sub> (3)	I <sub>F</sub> =10mA		0.40	0.36	V
	V <sub>F</sub> (4)	I <sub>F</sub> =30mA		0.50	0.44	V
	V <sub>F</sub> (5)	I <sub>F</sub> =100mA		1.00	0.7	V
反向击穿电压	V <sub>R</sub>	I <sub>R</sub> =100 μ A	30		40	V
反向漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =25V		2		μ A
结电容	C <sub>j</sub>	V <sub>R</sub> =1V,f=1MHZ		10.0		PF
反向恢复时间	t <sub>tr</sub>	I <sub>F</sub> =I <sub>R</sub> =10mA,R <sub>L</sub> =100 Ω ,I <sub>RR</sub> =0.1I <sub>R</sub>		5.0		ns